

RFスパッタ装置 SP-11000R



RFスパッタ装置SP-11000Rは4個のプラネタリ式基材取付台が、上部フランジに設けられており、同一水平面を保持しながらターゲット上部を自公転します。特定のプラネタリを選別したり、全プラネタリを使用してのスパッタリングが出来ます。酸素ガスの導入による反応性スパッタリングが可能で、ITO成膜に最適です。

RFスパッタ装置 SP-11000R 仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄10分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ550mm×300mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 1kW 自動マッチング 1台
○基板形状	A4サイズ 1枚
○膜厚分布	±10%以内
○ターゲット寸法	5インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	1
○基板回転	有り
○基板加熱	常温～250℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:800L/min 油拡散ポンプ:2000L/sec
○操作方法	手動
○ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相7kVA 冷却水:10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:2500mmW×2000mmD×1200mmH